

证券代码：688288

证券简称：鸿泉物联

公告编号：2022-020

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年7月1日，杭州鸿泉物联网技术股份有限公司（以下简称鸿泉物联或公司）召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，经全体董事和监事一致同意，审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司2022年可向各商业银行等金融机构申请综合授信总额增加至不超过人民币3亿元。

公司于2022年4月27日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议及5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于审议公司2022年度申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司（浙江鸿泉电子科技有限公司、浙江鸿泉车联网有限公司、上海成生科技有限公司、杭州叮咚知途信息技术有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司等）在2022年向各商业银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币2亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等综合授信业务，该项申请的有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件。

鉴于公司经营规模进一步扩大，资金需求相应增加，为更好地支持生产经营与业务发展，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及控股子公司（浙江鸿泉电子科技有限公司、浙江鸿泉车联网有限公司、上海成生科技有限公司、杭州叮咚知途信息技术有限公司、北京域博汽车控制系统有限公司等）拟将申请综合授信总额增加至不超过人民币3亿元，授信用途及授权范围不变。该议案尚需公司股东大会审议，因此该项申请的有效期自2022年第一次临时股东大会审议通过

之日至下一年度股东大会召开之日止。

具体授信额度和期限以公司签订的协议为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，以实际发生金额为准。

特此公告。

杭州鸿泉物联网技术股份有限公司

董事会

2022年7月2日